

បរទេសនុករម

1. W-J Jeong, G-C Park, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 65(2001) 37.
2. S.Ghosh, A.Sarkar, S.Chaudhuri, A.K.Pal, Thin Solid Films 205(1991)64.
3. A.Sarkar, S.Ghosh, S.Chaudhuri, A.K.Pal, Thin Solid Films 204(1993)255.
4. K.Tabuchi, W.Wenas, A.Yamada, Jpn. J. Appl. Phys 32(1993)3764.
5. F.S. Hickernell, Proc. IEEE Ultrasonic Symp (1980)785.
6. M.Chen, X.Wang, Y.H.Yu, Z.L. Pai, X.D. Bai, C.Sun, R.F. Huang, L.S.Wen, Appl. Surf. Sci. 158(2000)134.
7. B.J Lokhande, M.D. Uplane, Appl. Surf. Sci. 167(2000)243.
8. P.Nunes, E.Fortunato, P.Vilarinho, R.Martins , Inter. J. Inorg. Mater 3(2001)1211.
9. P.Nunes, E.Fortunato, R.Martins , Inter. J. Inorg. Mater 3(2001)1125.
10. S.A.Studenikin, N.Golego, M. Cocivera, J. Appl. Phys 87(2000)2413.
11. J.N. Zeng, J.K. Low, Z.M. Ren, T. Liew, Y.F Lu, Appl. Surf. Sci. 8087(2002)1.
12. X.L. Xu, S.P.Lau, J.S.Chen, Z.Sun, B.K.Tay, J.W.Chai, Mater.Semi.Conduc.Process. 4(2001)617.
13. F. Ng-Cheng-Chin, M. Roslin, Z H. Gu, TZ Fahidy, J.Phys.D:Appl.Phys. 31(1998)L71.
14. Y.Igasaki, T.Naito, K.Murakami, W.Tomoda, Appl. Surf. Sci.169-170(2002)512.
15. J.B.Lee, H.J.Kim, S.G.Kim, C.S.Hwang, S-H. Hong, Y.H. Shin, N.H.Lee, Thin Solid Films 435(2003)179.
16. K-K. Kim, J-H.Song, H-J.Jung, W-K.Chi, S-J Park,J-H Song, J. Appl. Phys 87(2000)3573.
17. K-K. Kim, J-H.Song, H-J.Jung, S-J Park, J-H Song, J-Y. Lee, J. Vac.Sci. Technol. A18(6)(2000)2864.
18. S.H. Jeong, J.W. Lee, S.B. Lee, J.H. Boo, Thin Solid Films 435(2003)78.
19. G.J. Fang, D. Li, B-L Yao, Thin Solid Films 418(2002)156.
20. D.Song, P.Widenborg, W. chin, A.G. Aberle, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 73(2002)1.
21. O. Kluth, A. Löffl, S.Wieder, C. Beneking, W. Appenzeller, L.Houben, B.Rech, H. Wagner,. Presented at the 26th IEEE PVSC, Anaheim (1997).

22. B.Rech, G.Schoepe, O. Kluth, T. Repmann,T. Roschek,J.Mueller,J.Huepkes, H.Stiebig.
Presented at 3rd World conference on Photovoltaic Energy Conversion WCPEC-3,
Osaka, Japan (2003).
23. T. Tohsophon, J. Hüpkes, H. Siekmann, B. Rech, M. Schultheis, N. Sirikulrat, Thin Solid
Films 516(2008) 4628.
24. T. Tohsophon , N. Sirikulrat, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 90 (2006) 3444.
25. J.A. Anna Selvan, A.E. Delahoy, S.Guo,Y-M. Li, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 90(2006)
3371.
26. M. Berginski, J. Hüpkes, M. Schulte, G. Schöpe, H. Stiebig, B. Rech, M. Wuttig, J. of
Applied Physics 101 (2007) 074903.
27. M.Kemell, F.Dartigues, M.Ritala, M.Leskela, Thin Solid Films 434(2003)20.
28. T. Minami, S.Suzuki, T.Miyata, Thin Solid Films 398-399(2001)53.
29. H. Enoki, T. Nakayama, J. Echigiya, Phys. Status Solid A 129(1992)181.
30. T. Minami, H.Sonohara, S.Takata, H.Sato, Jpn. J. Appl. Phys 33(1994)L1693.
31. H.Un'no, N.Hikuma, T.Omata, N.Ueda, T.Hashimoto, H.Kwazoe, Jpn. J. Appl. Phys
32(1993) L1260.
32. T.Minami, H.Sonohara, T.Kakumu, S.Takata, Jpn. J. Appl. Phys 34(1995) L971.
33. T.Minami, Y.Takeda, S.Takeda, T.Kakumu, Thin Solid Films 308-309 (1997)13.
34. T.Minami, T.Miyata; T.Yamamoto, J.Vac.Sci.Technol. A17(4)(1999)1822.
35. K.Tominaga, H.Fukumoto, K.Kondou, Y.Hayashi, K.Murai, T.Moriga, I.Nakabayashi, Vacuum
74(2004)683.
36. H. L. Hartnagel, D.L Dawar, A.K. Jain, C. Jagadish. (1996). *Semiconducting Transparent
Thin Films*. Institute of Physics Publishing Bristol and Philadelphia.
37. A.J.Moulson, J.M.Herbert. (2003). *Electroceramics : Material properties applications*.
2 nd edition, Chapman&Hall.
38. D.R. Askland. (1996). *The Science and Engineering of Materials*. 3 rd SI edition,
Chapman&Hall.
39. A.J.Moulson, J.M.Herbert. (1990). *Electroceramics : Material properties applications*.
Chapman&Hall.

40. B.G. Streetman. (1995). *Solid state Electronic Devices*. New jersey: Prentice-Hall international.
41. D.L.Smith. (1995). *Thinfilm Deposition:Principle and Practice*. McGraw-Hill, NewYork.
42. R.F. Bunshah. (1982). *Hand Book of Deposition Technologies for Films and Coatings*. New Jersey, Noyes Publications.
43. สุพัฒน์ พงศ์ ดำรงค์ตัน, พิเชฐ ลิมสุวรรณ และพิษณุ เจริญสมศักดิ์ “การวิจัยและพัฒนาการเคลือบพิล์มนบางด้วยวิธีสปั๊ตเตอร์ริง” รายงานการวิจัยประจำปี 2529 ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
44. สุรัsingh ไชยคุณ, นิรันดร์ วิทิตอนันต์, สกุล ศรีญาณลักษณ์ และจักรพันธ์ ถาวรธีรา “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเคลือบสารต่างๆด้วยวิธีสปั๊ตเตอร์ริง” รายงานการวิจัยประจำปี 2541 ของมหาวิทยาลัยบูรพา.
45. O.Kluth, B.Rech, H.Wagner, presented at 17th European Photovol. Solar Energy Conference (2001).
46. อุทัย ติยะวิสุทธิ์ “เทคนิค Glow Discharge สำหรับงานเคมีเคราะห์ในปัจจุบัน” วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2540.
47. สมพงศ์ นัตรภรณ์, ขจรยศ อุดมดี และ ชนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน “การเคลือบพิล์มนบางไมลิบดินม์โดยวิธีดีซีแมกนีตอرونสปั๊ตเตอร์ริง” วารสารโลหะ วัสดุและแร่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มิถุนายน 2537.
48. B.Chapman.(1980). *Glow Discharge Process*, New York, John Wiley & Sons.
49. J.L. Vossen, W. Kerns. (1978). *Thin Film Processes*. New York: Academie Press.
50. M. Ohring. (1997). *The Materials Science of Thin Films*. Thin Film Technology Handbook: McGrow-Hill Companies international.
51. M.R. Robert (1966). *The Structure and Properties of Materials*. New York: John Wiley & Son.
52. แม้น ออมรสิทธิ์ และ สมชัย อัครทิวา. (2529). วัสดุวิศวกรรม. กรุงเทพฯ: ห้อง.
53. เกษรารัตน์ อัครรัตน์. (2545). พิล์มนบางโนร์ฟล์ฟ ZnO(AI) เตรียมโดยօร์ເອົບແລະດີซີມກນິຕອຣອນສປັດເຕອຮົງແບບດາມລຳດັບ. ປະໂຫຍດວຸນພັນທະນາ ວ.ທ.ມ. (ຟິສິກສ). กรุงเทพฯ: ບັນຈິດ ວິທາລ້ຽມທະນາຄານ.
54. F. Abeles. (1972). *Optical Properties of Solids*. Natherland: North-Holland.
55. E.J. Johnson. (1967). *Semiconductor and Semimetal*. USA: Academic Press.

56. Ian J. McColm. (1994). *Dictionary of Ceramic Science and Engineering*. New York: Plenum Press.
57. N. Senoussaoui, T. Repmann, T. Brammer, H. Stiebig, H. Wagne, Rev. Energ. Ren. Vol.3 (2000) 49.
58. Images scientific instruments. (2007). *The four point electrical probe*. Retrieved February 12, 2010, from <http://www.imagesco.com/articles/superconductors/four-point-electrical-probe.html>
59. พรรณพิพย์ ตั้งปริยาภรณ์. (2551). เครื่องตรวจวัดสารตัวยการดูดกลืนแสง. สืบคันเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2553, จาก <http://www.mwit.ac.th/~sarawoot/chem40235.htm>
60. O. Madelung. (1992). *Semiconductor Group IV Element and III-V Compound*. n.p.: Springer-Verlag.

Out put

1. ผลงานวิจัยนี้ได้เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thin Solid Films ในเรื่อง *Effect of Aluminum and Indium co-doping on Zinc oxide transparent conductive films prepared by dc magnetron sputtering using ceramic target* ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบรับ
2. -การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย โดยจากผลงานวิจัยในครั้งนี้ หากมีการนำฟิล์ม AlZO ไปประยุกต์ใช้เป็นฟิล์มโปร่งใสสำไฟฟ้า (TCO) ในเซลล์แสงอาทิตย์ จะเป็นการลดขั้นตอนการผลิตและต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก กล่าวคือ
 1. ลดขั้นตอนในการให้ความร้อนแก่แผ่นรองรับ เนื่องจากฟิล์ม AlZO มีค่าสgap ต้านทานไฟฟ้า ความโปร่งใสสูง เมื่อเตรียมที่อุณหภูมิห้องโดยไม่จำเป็นต้องให้ความร้อนกับแผ่นรองรับเหมือนฟิล์ม TCO โดยทั่วไป
 2. ลดขั้นตอนการกัดฟิล์มด้วยกรดเพื่อเพิ่มความขุ่นระขของฟิล์ม ซึ่งมีผลต่อไลท์ แควรป-ปั๊งในเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องด้วยฟิล์ม AlZO มีความขุ่นระขและมีค่าเชชูงแม่จะไม่ถูกกัดด้วยกรดก็ตาม
 -การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ โดยมีความร่วมมือในการทำวิจัยกับนักวิจัยต่างประเทศ (Dr. Kah-Yoong Chan ประเทศไทยมาเลเซีย) ซึ่งมีความสนใจในการพัฒนาฟิล์มตระกูลชิงค์ออกไซด์ โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิตเหมือนกัน
 -การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ โดยเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา พศ 362 พลิกส์และเทคโนโลยีสัญญาณและวิชา พศ 466 ผลักวิทยาวังสีเอ็กซ์เรย์ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนวิชาดังกล่าว อีกทั้งเป็นการปูทางให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่โดยส่วนหนึ่งของงานวิจัยได้เป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทด้วย
3. -ผลงานส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้ได้ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2554 ในหัวข้อเรื่อง การเตรียมฟิล์มบางชิงค์ออกไซด์เจือด้วยออกซูมิเนียมและอินเดียมด้วยเทคนิคดีซี แมgnetiตrovon สปั๊ดเดอริง โดยใช้เป้าเซรามิกส์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ
 -เสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง 18th International Vacuum Congress (IVC-18) ณ เมือง ปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2553 ในหัวข้อ Thin Films โดยได้เสนอผลงานวิชาการในรูปโปสเตรอร์ในวันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 12.00-14.00 น.

ภาคผนวก

1. Manuscript เรื่อง Effect of aluminum and indium co-doping on zinc oxide transparent conductive thin films prepared by dc magnetron sputtering using ceramic target
เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thin Solid Films
2. Manuscript เรื่อง การเตรียมฟิล์มบางชิงค์ออกไซด์เจือด้วยอลูมิเนียมและอินเดียมด้วยเทคนิคดีซี แมกนีตرون สปัตเตอริ่ง โดยใช้เป้าเซรามิกส์ ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศว. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม 2554

Elsevier Editorial System(tm) for Thin Solid Films
Manuscript Draft

Manuscript Number:

Title: Effect of Aluminum and Indium co-doping on Zinc oxide transparent conductive films prepared by dc magnetron sputtering using ceramic target

Article Type: IVC-18 2010

Keywords: dc magnetron sputtering; ceramic target; TCO films; zinc oxide films

Corresponding Author: Dr Thanaporn Tohsophon, Ph.D

Corresponding Author's Institution: Srinakharinwirot University

First Author: Thanaporn Tohsophon, Ph.D

Order of Authors: Thanaporn Tohsophon, Ph.D; Nuntanut Wattanasupinyo, Master; Buncha Silskulsuk, Master; Narin Sirikulrat, Ph.D

Abstract: Aluminum and Indium co-doped Zinc Oxide (AlZO) thin films were prepared by direct current (dc) magnetron sputtering on glass substrate in pure argon atmosphere. Three inches of zinc oxide ceramic with 0.5 wt% of aluminum and indium doping was used as a target in static mode. The influence of sputtering conditions i.e. substrate-target distance, pressure and power on AlZO films were studied. The microstructure and electrical resistivity of thin films were investigated by scanning electron microscope and Hall effect measurement. The optical transmittance of AlZO films was measured by UV visible spectrophotometer in the wavelength of 300-1100 nm. Depending on the deposited conditions, highly transparent films up to 80% with lowest resistivity of $2.6 \times 10^{-4} \Omega\text{cm}$ was achieved at room temperature. Possible mechanism will be discussed.

EFFECT OF ALUMINUM AND INDIUM CO-DOPING ON ZINC OXIDE TRANSPARENT CONDUCTIVE FILMS PREPARED BY DC MAGNETRON SPUTTERING USING CERAMIC TARGET

T.Tohsophon¹, N. Wattanasupinyo¹, B. Silskulsuk¹ and N. Sirikulrat²

¹Physics department, Faculty of Science, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand

²Physics department, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand

Abstract

Aluminum and Indium co-doped Zinc Oxide (AIZO) thin films were prepared by direct current (dc) magnetron sputtering on glass substrate in pure argon atmosphere. Three inches of zinc oxide ceramic with 0.5 wt% of aluminum and indium doping was used as a target in static mode. The influence of sputtering conditions i.e. substrate-target distance, pressure and power on AIZO films were studied. The microstructure and electrical resistivity of thin films were investigated by scanning electron microscope and Hall effect measurement. The optical transmittance of AIZO films was measured by UV visible spectrophotometer in the wavelength of 300-1100 nm. Depending on the deposited conditions, highly transparent films up to 80% with low resistivity in the range of $2.6 - 7.9 \times 10^{-4} \Omega\text{cm}$ were achieved at room temperature. Possible mechanism will be discussed.

Keywords: dc magnetron sputtering, ceramic target, TCO films, zinc oxide films



1. Introduction

The transparent conductive oxide (TCO) layer plays an important role for silicon solar cells which is used as front electrode and part of back side reflector. The quality of solar cells strongly depends on the quality of TCO films. Most widespread TCO materials for photovoltaic applications are tin oxide (SnO_2) and indium tin oxide (ITO) films. However, an alternative with high potential is aluminum doped zinc oxide (AZO) films because of abundant and inexpensive materials, its simple fabrication and the high stability against hydrogen plasmas. Due to these unique properties, AZO films have been applied as transparent conducting electrodes in silicon thin film solar cells [1-3].

The physical properties of AZO films are generally dependent on deposition parameter and technique. Sputtering technique with high substrate temperature leads to highly conductive and transparent films but smooth surface. Therefore, wet chemical etching of as deposited films is applied to texture the films surface in order to enhance light trapping in the solar cells [4]. In addition, the transparent conductive indium doped zinc oxide films (IZO) has also been studied [5]. It was expected to yield the films transmittance and conductivity due to their low resistivity ($3 \times 10^{-4} \Omega\text{cm}$) with high carrier concentrations of $5 \times 10^{20} - 1 \times 10^{21} \text{ cm}^{-3}$. Furthermore, it was reported that lowest resistivity in $1.5-2 \times 10^{-4} \Omega\text{cm}$ was achieved by simultaneous sputtering of Zn:Al and In_2O_3 targets [6]. However, heated substrate is still necessary. Although excellent AZO films are achieved with radio frequency (rf) sputtering [7-9], however, low deposition rate, high equipment costs and high ceramic targets expense of this technique lead to the development of alternative processes. The high investment costs can be overcome by direct current (dc) sputtering, leading to distinctly higher deposition rates.

The present work focuses on aluminum and indium co-doped zinc oxide films (AlZO) prepared by dc magnetron sputtering using ceramic targets. The influence of sputtering conditions, i.e. substrate-target distance, deposited pressure and power, on AlZO films properties have been investigated. In view of the application as front contact/back reflector in silicon thin film solar cells, the low manufacture temperature for TCO films is required. Therefore, high conductive as well as good transparent films grown at room temperature have been reported in this study.

2. Experimental details

AIZO films were prepared by static dc magnetron sputtering on corning 2947 glass. Three inches zinc oxide ceramic doped with 0.5 wt% of Al_2O_3 and In_2O_3 prepared by conventional mixed oxide method was used as a target. The mixtures were ground in ethanol by ball milling for over 24 h, then dried, pressed in the mold and sintered at 1320°C for 8 h in air. The three inches ceramic target with thickness of 1 cm showed good conductive characteristic. In order to prepare thin films with good adhesion, the substrates were cleaned in an ultra-sonic bath with de-ionized water, acetone, isopropyl alcohol (IPA) and then dried. Corning 2947 glass was placed parallel to the target with different distances from 7-16 cm. AIZO films were deposited for 30 min at room temperature with various deposited conditions, i.e. pressure and power. Before sputtering, the chamber was evacuated at a base pressure of 6×10^{-3} Pa. Pre-sputtering process was done for 10 min on the shutter to clean the target surface. The argon flow rate was controlled by a needle valve.

The electrical properties of the films were investigated by four point probe technique (JANDEL, RM3) and Hall effect measurement (ECOPIA, HMS-3000). The optical properties of AIZO films were analyzed by a UV visible spectrophotometer (Perkins Elmer, Version 2.85.04) in the wavelength of 300-1100 nm. The surface morphology was studied by scanning electron microscopy (Hitachi, S4700). The film thickness was measured by using Step profile (Veeco, Dektak 150).

3. Results and Discussions

3.1 Electrical properties

Figure 1 presents resistivity, carrier concentration and electron mobility of AIZO films as a function of the deposited pressure. AIZO films were deposited at 40 W with different substrate-target distance from 7 to 16 cm. Depending on the sputtering condition, resistivity of the films in the range of $1 \times 10^0 - 7.9 \times 10^{-4}$ Ωcm with the carrier concentration of $2 \times 10^{15} - 5 \times 10^{17}$ cm^{-3} and electron mobility of $1 \times 10^{-1} - 4 \times 10^3$ cm^2/Vs were obtained. Moreover, AIZO films prepared at substrate-target distance of 7 cm give raise to electron mobility up to $1000 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ for all pressures, while the other conditions give less. With an increase of the deposited pressure, the resistivity of AIZO films deposited at substrate-target distance of 7 cm tend to decrease (Fig 1a), while the films prepared at the distance of more than 7 cm show inverse trend (Figs. 1b,1c,1d). This result can be explained by the energy of sputtered AIZO atom when deposited on the substrate. As the short substrate-target distance, high energy of sputtered AIZO atom can deposited on the substrate without energy loss due to ion hitting in the plasma.

On increasing the pressure, the number of argon ions in plasma is increased, resulting in an increase of the sputtered AIZO atoms. Therefore, plenty of energy loss-free AIZO atom deposit on the substrate. This leads to dense and thick films with low resistivity. On increasing the substrate-target distance, sputtered AIZO atom lose the energy by colliding the plasma. The higher the pressure, the lower the energy of the deposited atom is obtained. This sputter process leads to low compact and thin films ($<400 \text{ nm}$) with high resistivity. These arguments are confirmed by film thickness and film morphology as shown in Fig. 2 and Fig. 5, respectively. Furthermore, on increasing the power of 50 W the lowest resistivity of 2.6×10^{-4} Ωcm is achieved

(not shown here). The higher the power, the higher the energy of the sputtered AIZO atom is deposited, resulting in higher compact films with lower resistivity.

3. 2 Optical transmittance

Figure 3 shows the optical transmittance spectra of AIZO films prepared at the power of 40 W and substrate-target distance of 10 cm with various deposited pressure as a function of the wavelength. Sharply increasing of films transmittance is observed in the wavelength of 350-400 nm. All films exhibit the average transmission of more than 80% throughout the visible region (400-800 nm) and then slightly drop in the NIR region (800-1100 nm). There are two main optical absorption mechanisms causing transparency of AIZO films, the absorption at the band edge and the absorption of the free charge carriers. When the energy of the light incident on the AIZO is greater than the band gap energy (E_g), it will be absorbed by electrons which will undergo interband transitions. Above the critical wavelength (λ_g) corresponding to E_g , the absorption falls drastically with a simultaneous rise in transmittance, as there is not enough energy to excite the electrons from their stable state. However, as the wavelength increases beyond approximately 800 nm, the free carrier electrons in the AIZO will begin to absorb the light. The more the free carriers, the more absorption is obtained. Thus the transmission in NIR region slightly decreases as the carrier concentration increases.

Figure 4 presents the average transmission of AIZO films in the wavelength of 400-1100 nm prepared at various deposited condition. It can be seen that at the short distance of 7 cm, low average transmission is demonstrated throughout the deposited pressure, particularly at the pressure lower than 5 Pa. On the other hand, the optical transmittance of the films show over 80% in visible and NIR region for the other deposited conditions.

The above mentioned optical band gap depends on the absorption coefficient (α) as:

$$(\alpha h\nu)^2 = A(h\nu - E_g)$$

where h is the Plank's constant, ν the frequency and A a constant.

The optical band gap energy, E_g , has been estimated by extrapolating the linear portion of the curve between $(\alpha h\nu)^2$ and $h\nu$ to the $h\nu$ axis. The band gap energy is found oscillating between 3.29-3.65 eV for various deposited conditions. Therefore, the absorption edge is shift to UV region. In comparison, the band gap energy of AIZO is in between that of AZO (3.42eV) reported by X.Q. Meng [10] and IZO (3.37-3.95 eV) reported by Gupta et al.[11]. It is expected that the increase of AIZO band gap compared to AZO is caused by the increase in carrier concentration as a result of the doping with indium.

Figure 5 shows the cross section and surface morphology of AIZO sputtered at power 50 W with deposited pressure of 3, 7 and 10 Pa. It is clearly seen that the deposited pressure of 3 Pa give columnar structure and uniform film with grain size of 50-300 nm (Figs. 5a and 5b). While film prepared at higher pressure of 10 Pa, granular surface with average grain size of 30 nm is obtained, as shown in Figs. 5e and 5f. This phenomenon can be described by the energy of deposited atom as above mentioned. The higher the pressure, the more energy-loss sputtered atom are produced, resulting in lower compact films and thickness. This agrees well with the results of the electrical properties.

4. Conclusions

In this work, AIZO thin films have been deposited on glass substrates by dc magnetron sputtering from ceramic target at room temperature. It has been found that the sputtering conditions have a significant effect on the electrical resistivity, optical transmittance and microstructure of AIZO films. On increasing the deposited pressure, the resistivity of the films grown at short target-substrate distance of 7 cm tends to decrease, whereas at distances longer than 7 cm, the films resistivity shows inverse tendency. In additions, an average optical transmittance of over than 80% in visible and NIR region with the band gap energy of 3.29-3.65 eV are achieved in the films grown at target-substrate distance of more than 7 cm. High transparent (>80%) and conductive AIZO films ($2.6 \times 10^4 \Omega\text{cm}$) is fabricated without heated substrate process. These results demonstrate that AIZO films grown at room temperature can be used as TCO thin films for solar cells.

Acknowledgements

The authors thank NECTEC, Thailand for sample measurements. We acknowledge T. Nilkamjon and S. Rengrat at Department of Physics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University for extensive technical assistance and A. Sangjakrawan for ceramic target preparation. This project is supported by Thailand Research Fund.

References

- [1] O. Kluth, B. Rech, L. Houben, S. Wieder, G. Schöpe, C. Beneking, H. Wagner, A. Löfll, H. W. Schock, *Thin Solid Films* 351 (1999) 247.
- [2] T. Tohsophon, J. Huepkes, H. Siekmann, B. Rech, M. Schultheis, N. Sirikulrat, *Thin Solid Films* 516 (2008) 4628.
- [3] B. Rech, T. Repmann, M.N. van den Donker, M. Berginski, T. Kilper, J. Hüpkes, S. Calnan, H. Stiebig, S. Wieder, *Thin Solid Films* 511-512 (2006) 548.
- [4] J. Müller, B. Rech, J. Springer, M. Vanecek, *Solar Energy* 77 (2004) 917.
- [5] K. Tominaga, T. Murayama, I. Mori, T. Okamoto, K. Hiruta, T. Moriga, I. Nakabayashi, *Vacuum* 59 (2000) 546.
- [6] K. Tominaga, H. Fukumoto, K. Kondou, Y. Hayashi, K. Murai, T. Moriga, I. Nakabayashi, *Vacuum* 74 (2004) 683.
- [7] R. Das, T. Jana, S. Ray, *Sol. Energy Mater. Sol. Cells* 86 (2005) 207.
- [8] G. Fang, D. Li, B.-L. Yao, *Thin Solid Films* 418 (2002) 156.
- [9] S.H. Jeong, J.W. Lee, S.B. Lee, J.H. Boo, *Thin Solid Films* 435 (2003) 78.
- [10] X.Q. Meng, W. Zhen, J.P. Guo, X.J. Fan, *Appl. Phys. A* 70 (2000) 421.
- [11] R.K. Gupta, K. Ghosh, R. Patel, S.R. Mishra, P.K. Kahol, *J. Cryst. Growth* 310 (2008) 3019.

Figure captions

Fig.1 Resistivity, carrier concentration and mobility of AIZO films prepared at room temperature with substrate-target distance of (a) 7 cm (b) 10 cm (c) 13 cm and (d) 16 cm.

Fig.2 Thickness of AIZO films prepared at room temperature and power of 40 W with various substrate-target distance (■ 7cm ● 10cm ▲ 13 cm ★ 16 cm).

Fig.3 Transmittance spectra and carrier concentration of AIZO films prepared at various deposited pressures.

Fig.4 Average transmittance (400-1100 nm) of AIZO films grown at different substrate-target distance and power.

Fig.5 Cross section and surface morphology of AIZO films prepared at 50 W and the substrate-target distance of 10 cm with pressure of (a) (b) 3 Pa (c) (d) 7 Pa and (e) (f) 10 Pa, respectively.

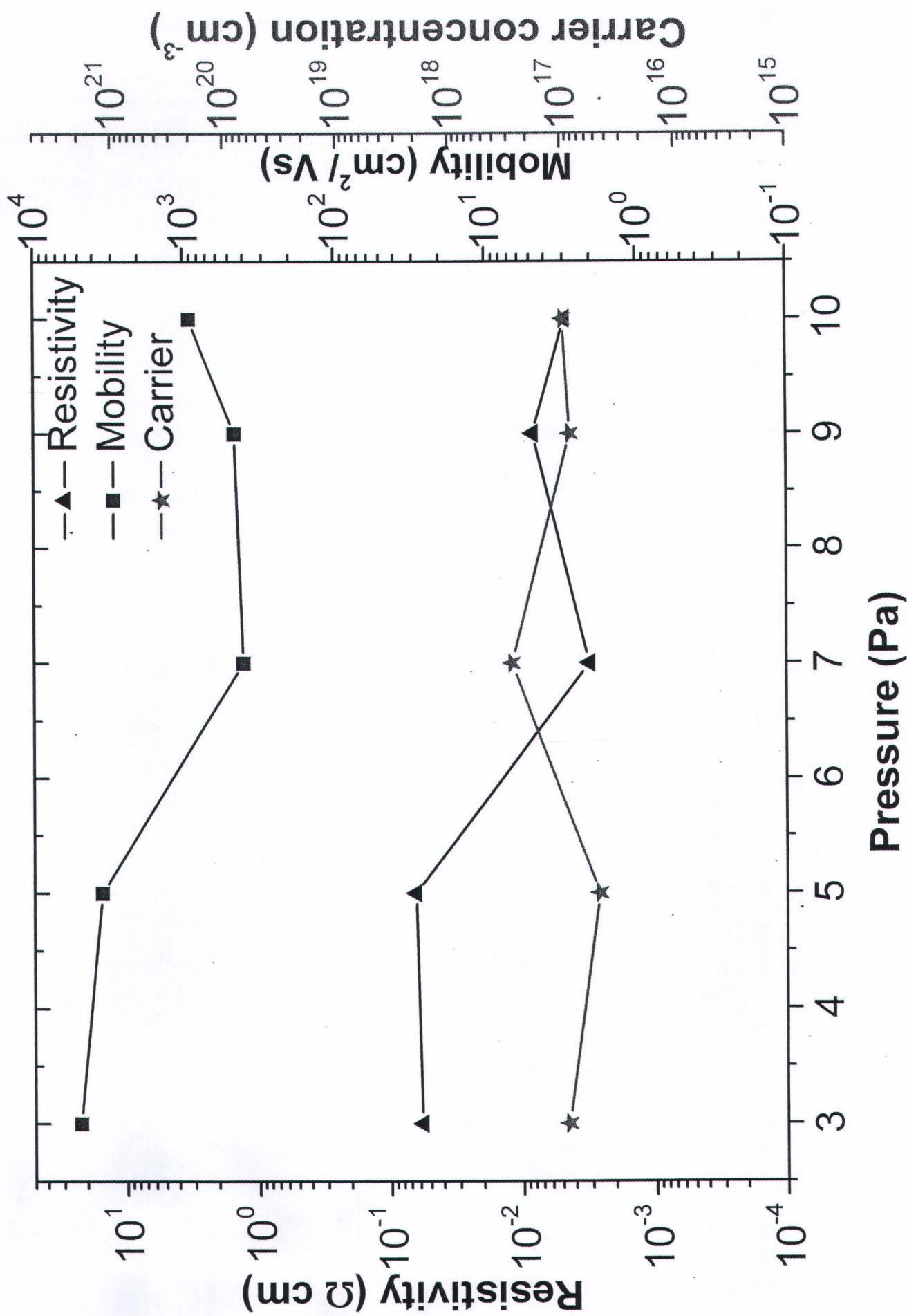
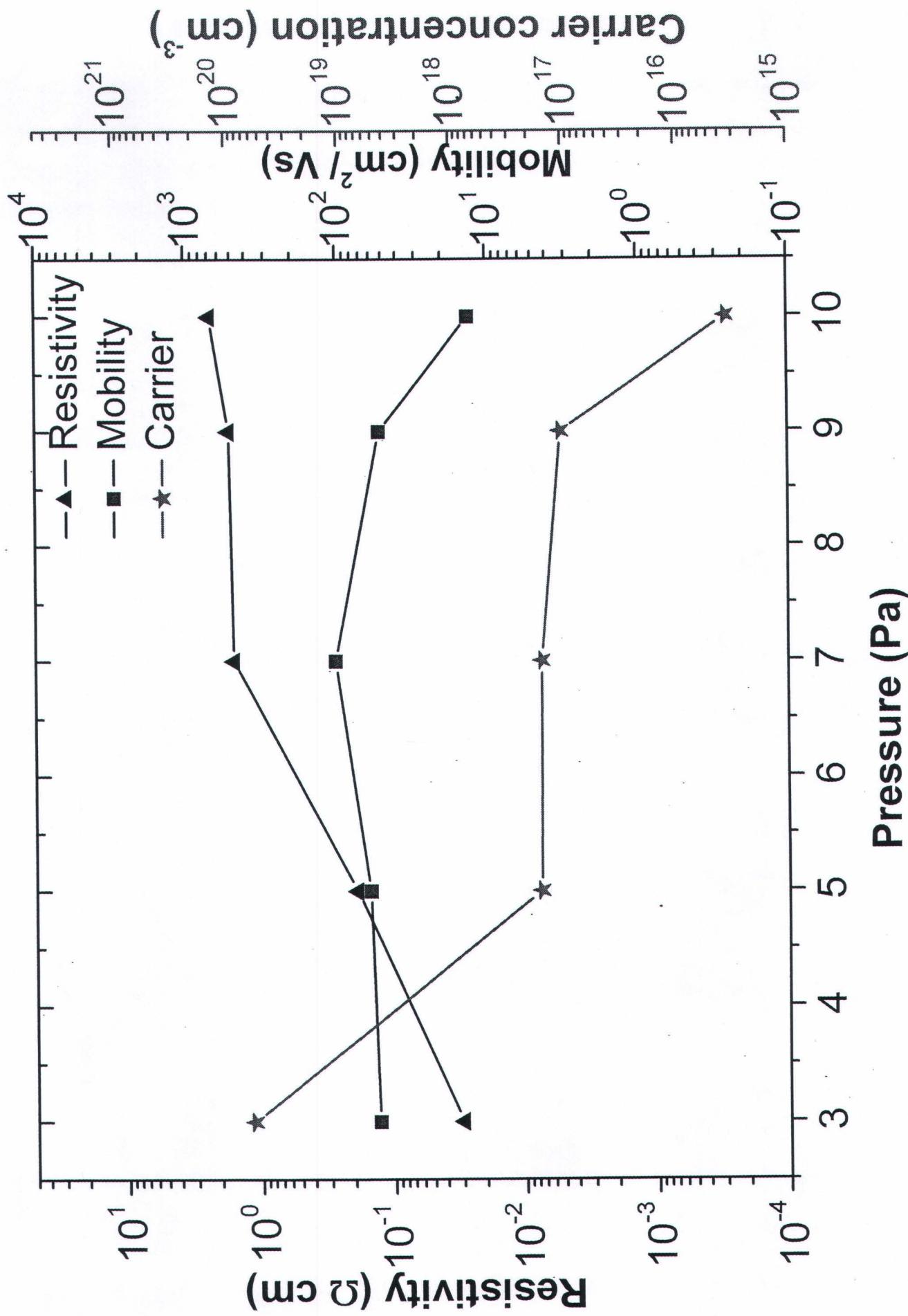


Figure 1a
Click here to download Figures (if any): fig.1a.pdf

Figure 1b
Click here to download Figures (if any): fig.1b.pdf



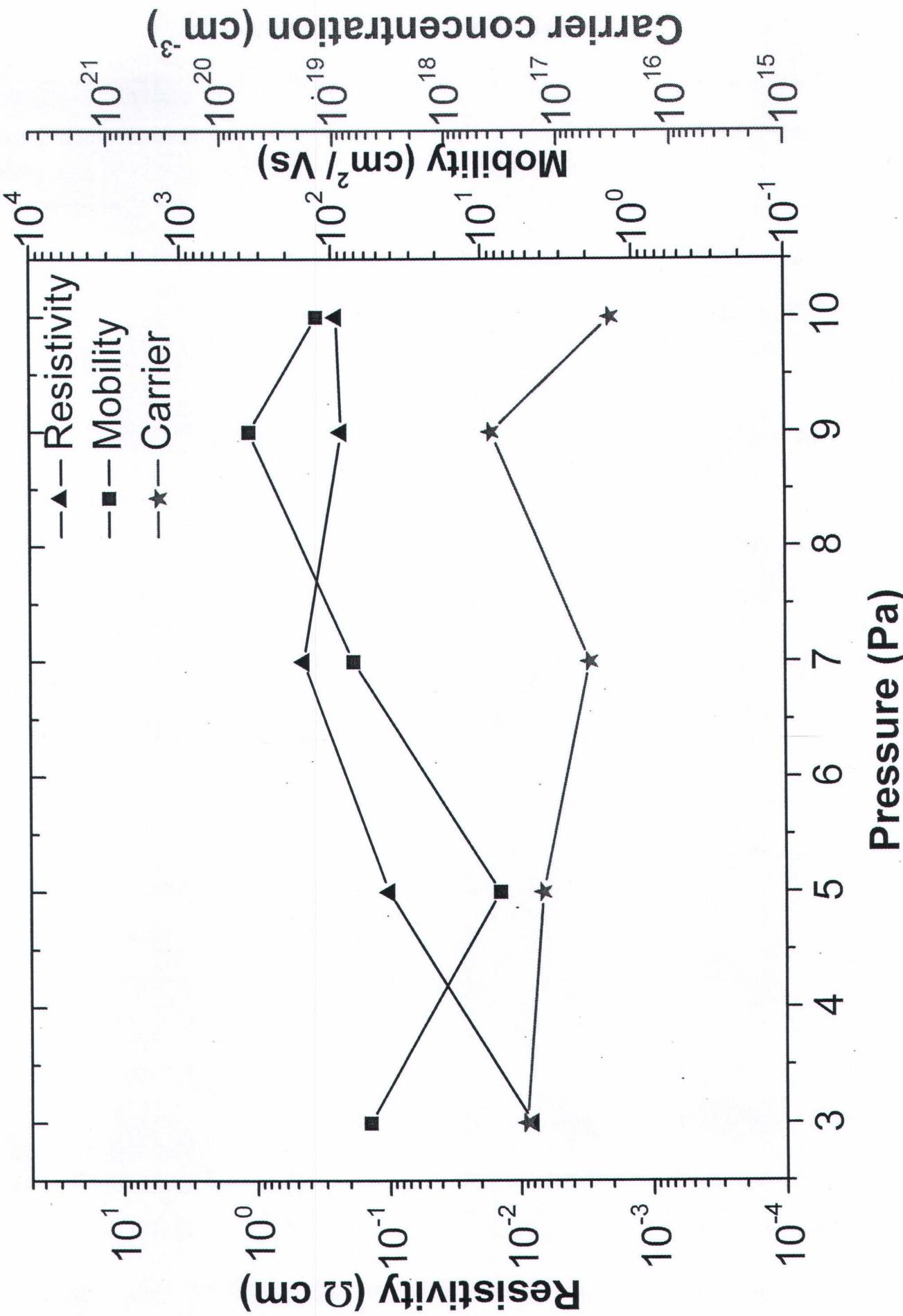


Figure 1c
Click here to download Figures (if any): fig.1c.pdf

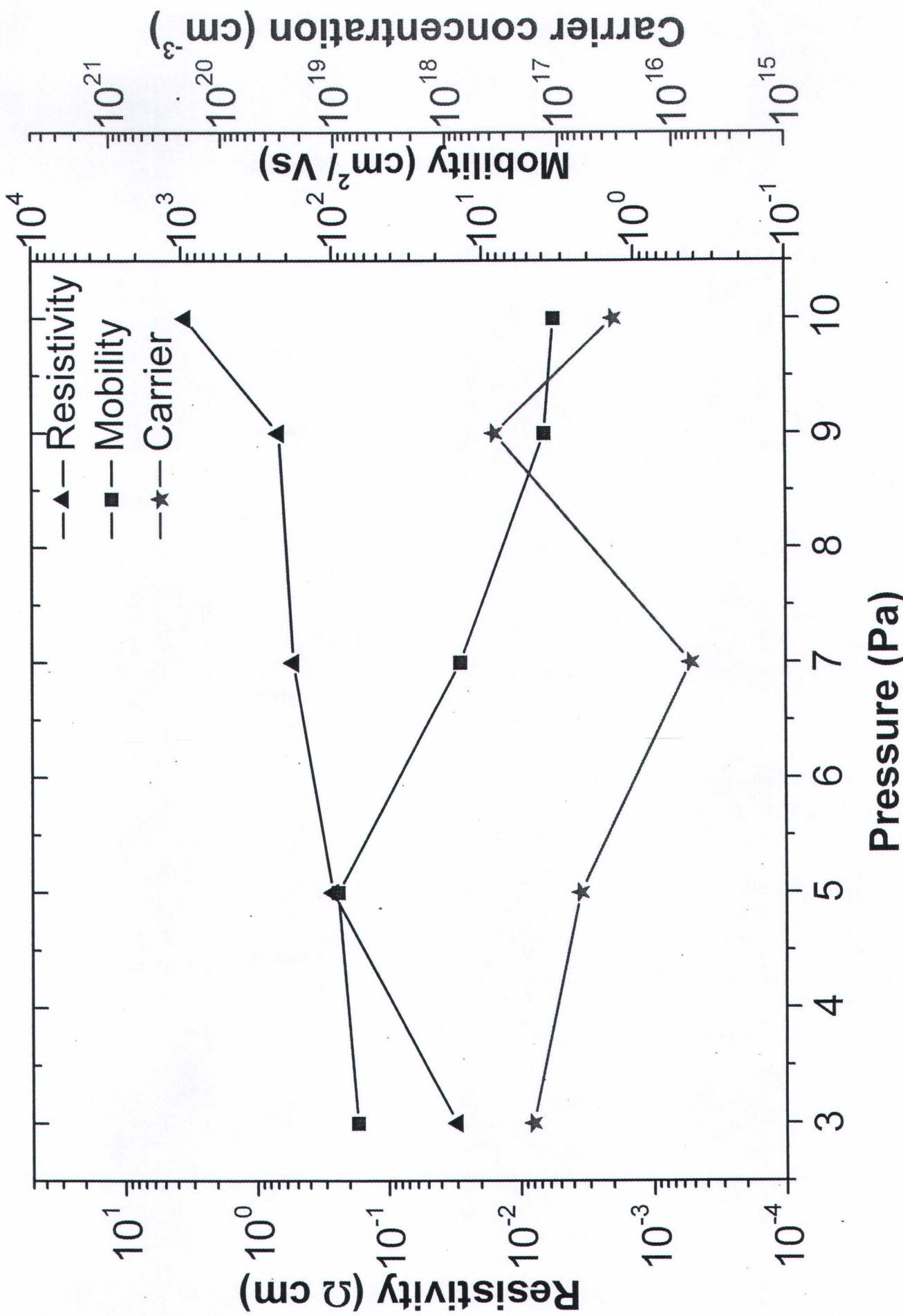
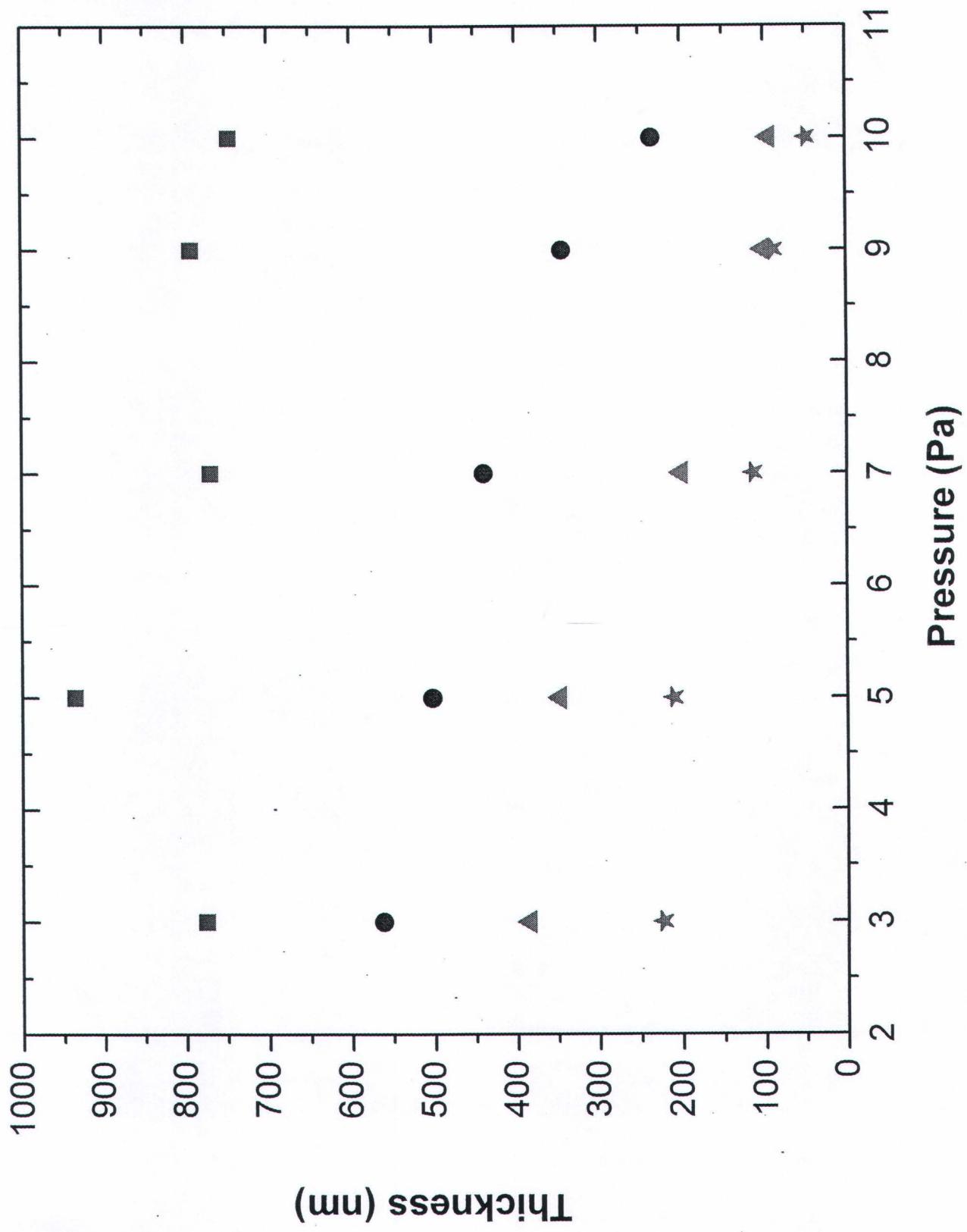


Figure 1d
Click here to download Figures (if any): fig.1d.pdf

Figure 2
Click here to download Figures (if any): fig.2.pdf



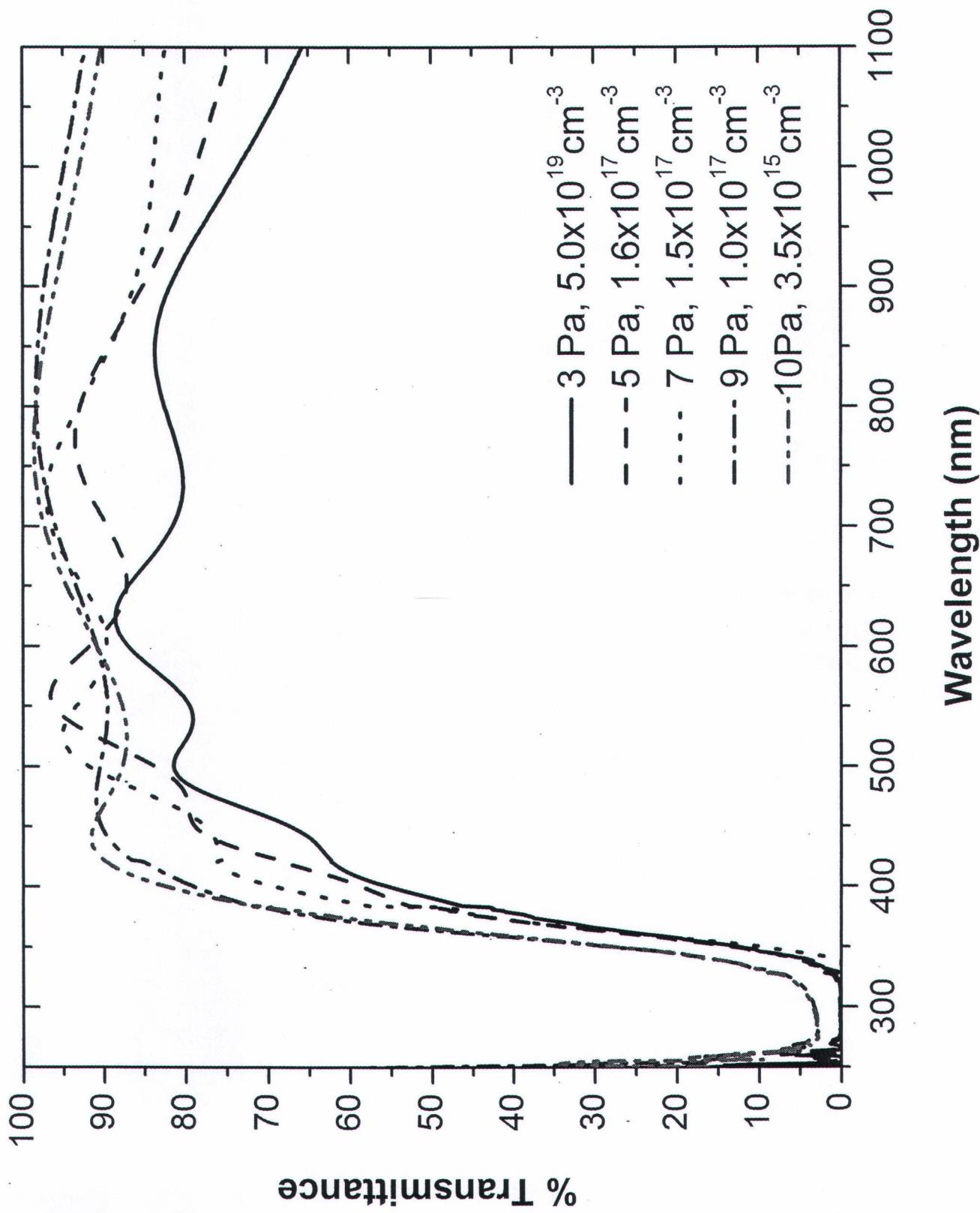


Figure 3
Click here to download Figures (if any): fig.3.pdf

Figure 4
Click here to download Figures (if any): fig.4.pdf

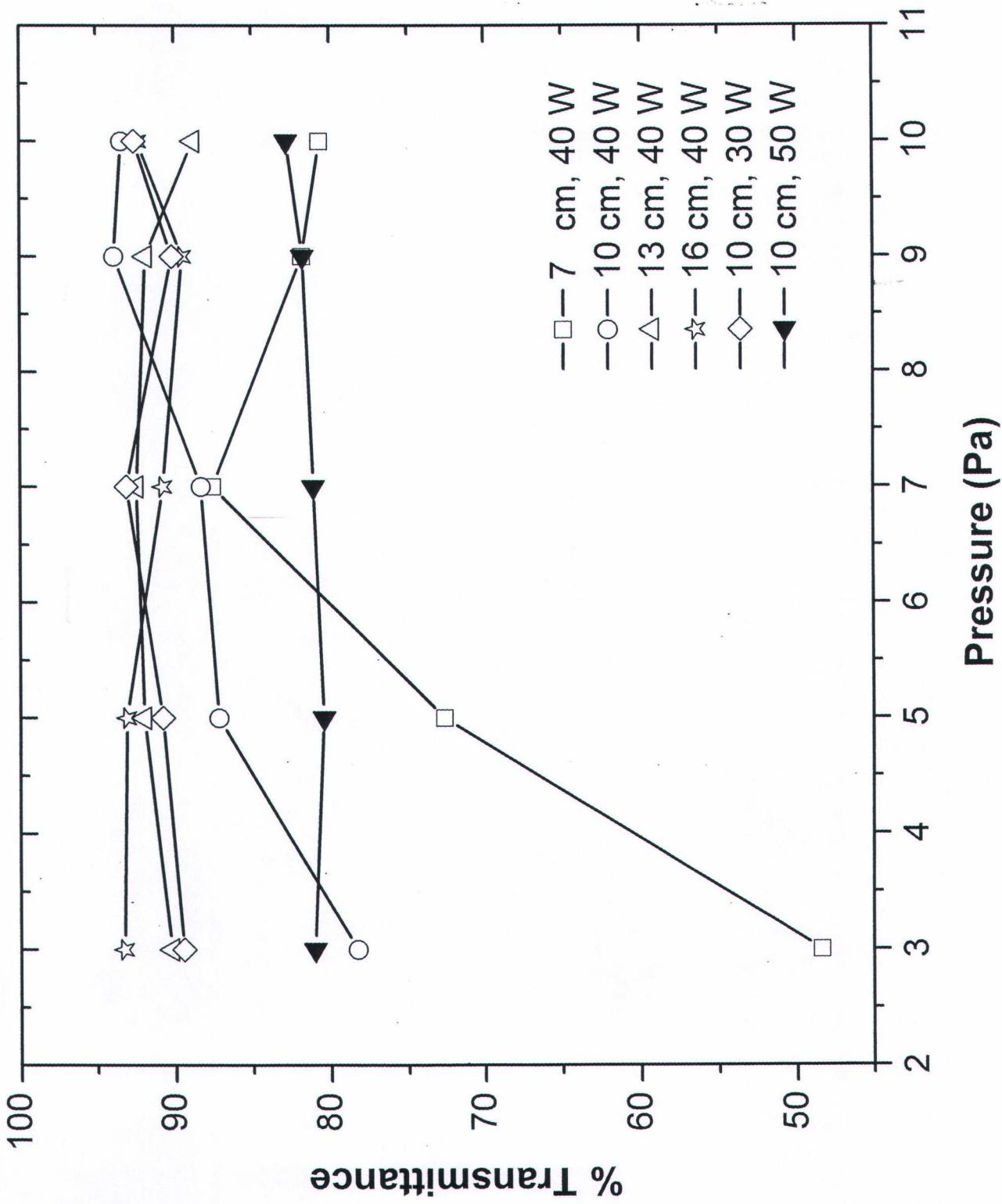
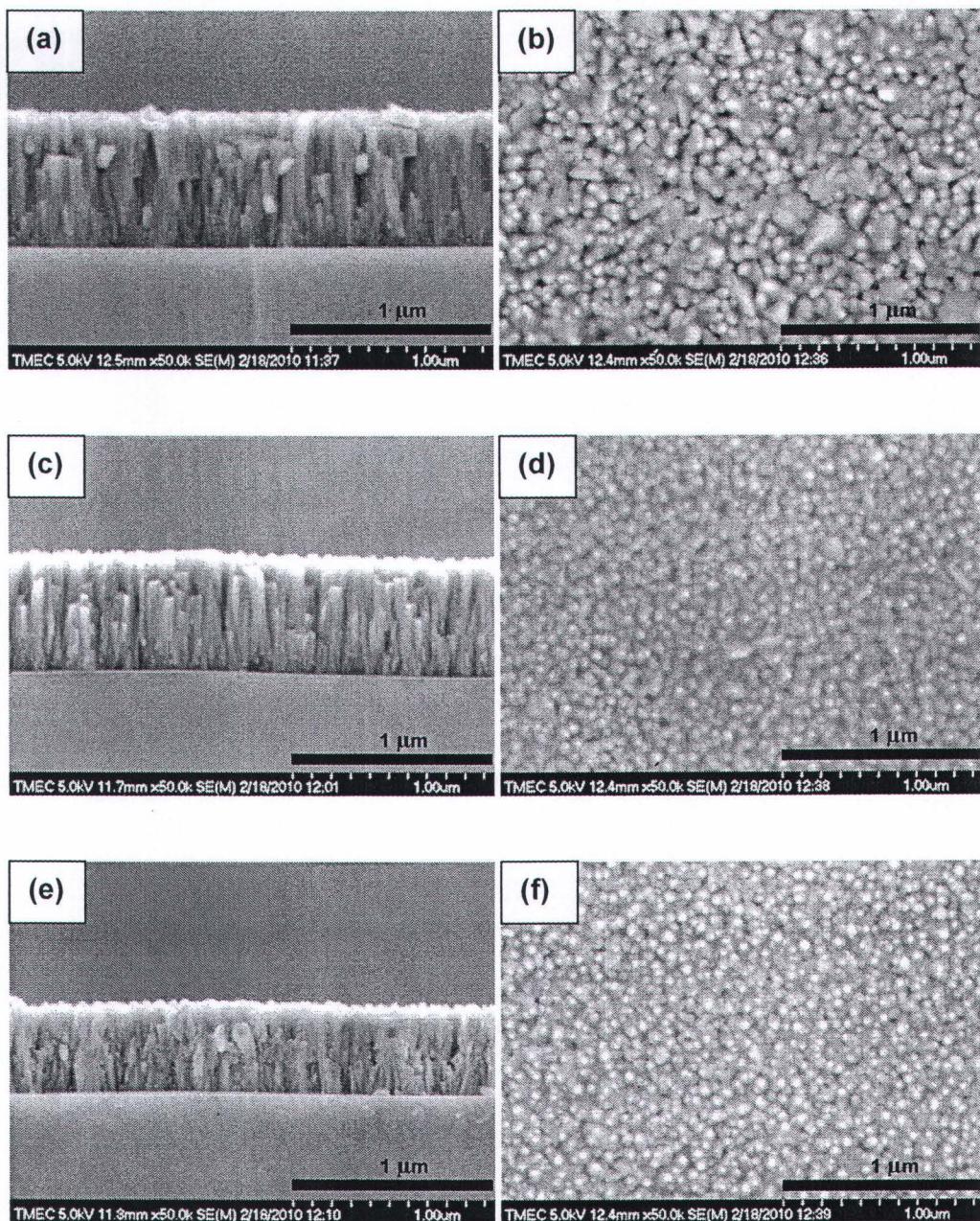


Figure 5

Click here to download Figures (if any): fig. 5.pdf



บทความวิจัย

การเตรียมฟิล์มบางชิงค์ออกไซด์เจือด้วยอัลูมิเนียมและอินเดียมด้วยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง โดยใช้เป้าเซรามิกส์

นันทนัช วัฒนสุกิจญ์¹ อ้อมตะวัน แสงจักรวาพ² บัญชา ศิลป์สกุลสุข¹
ณรงค์ พลโภค¹ และ ธนกรณ์ โตโสกณ^{1*}

บทคัดย่อ

ได้ประสบความสำเร็จในเตรียมฟิล์มบางชิงค์ออกไซด์เจือด้วยอัลูมิเนียมและอินเดียม (AlZO) โดยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง บนแผ่นรองรับที่เป็นกระจกในบรรยากาศของกัมบิสูหาร์ ณ อุณหภูมิห้อง โดยใช้เซรามิกส์ชิงค์ ออกไซด์เจือด้วยอัลูมิเนียมและอินเดียมในปริมาณ 0.5 wt% ขนาด 3 นิ้วที่เตรียมเองในห้องปฏิบัติการเป็นเป้า ศึกษา อิทธิพลของเงื่อนไขของการสปัตเตอริ่งได้แก่ ระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับ ความดัน และกำลังไฟฟ้า ที่มีต่อการทับถมของฟิล์ม โดยตรวจสอบจากความหนาและภาพตัดขวางของฟิล์มด้วยเครื่องวัดความหนาของฟิล์มและกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกล้อง (Scanning Electron Microscope : SEM) ตามลำดับ พบว่าเงื่อนไขการเตรียมฟิล์มที่ ระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 7 cm จะให้ฟิล์มที่มีอัตราการทับถมดีที่สุด (25-32 nm/min) มีความหนาสูงสุด ในช่วง 750-950 nm โดยไม่ขึ้นกับความดันขณะสปัตเตอร์ ขณะที่ระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับที่เพิ่มขึ้น อัตราการทับถมของฟิล์มจะลดลงและขึ้นกับความดันอย่างชัดเจน โดยการเตรียมฟิล์มที่ความดันต่ำจะให้อัตราทับถมของฟิล์ม สูงกว่าและมีความหนาแน่นมากกว่าที่ความดันสูง และการเพิ่มกำลังไฟฟ้าจะทำให้ฟิล์มมีอัตราการทับถมสูงขึ้น โดยฟิล์มเตรียมที่ระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับมากถึง 16 cm ความดันสูงที่ 0.1 mbar จะมีอัตราการทับถมต่ำสุด (1.7 nm/min) และมีความหนาเป็น 50 nm โดยจะอภิปรายกลไกที่เป็นไปได้ในงานวิจัยนี้

คำสำคัญ: ฟิล์มบางชิงค์ออกไซด์ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง เป้าเซรามิกส์

¹ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

² หมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนไนท์อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

* ผู้นิพนธ์ประสานงาน, email: thanapor@swu.ac.th

Preparation of Aluminium and Indium Doped Zinc Oxide Thin Films Prepared by DC Magnetron Sputtering Using Ceramic Target

Nuntanut Wattanasupinyo¹ Aomtawan Sangjakrawan² Buncha Silskulsuk¹
Nason Phonphok¹ and Thanaporn Tohsophon^{1*}

ABSTRACT

We succeed to fabricate Aluminum and Indium doped Zinc oxide (AlZO) thin films by direct current (dc) magnetron sputtering on glass substrate in pure argon atmosphere at room temperature. Three inches home made of zinc oxide ceramic with 0.5 wt% of aluminum and indium doping was used as a target. The influence of sputtering conditions -- target-substrate distance, pressure and power -- on AlZO deposition were studied. Films thickness and cross sections were investigated by surface profiler and scanning electron microscope (SEM), respectively. At the target-substrate distance of 7 cm, the films show optimum deposition rate (25-32 nm/min) with the thickness of 750-950 nm throughout the deposited pressure, indicating that the deposited rate not depend on the pressure. While at the higher target-substrate distance, the lower deposited rate depending on the pressure is obtained. The lower pressure, the higher deposited rate with dense films are grown. In addition, as increasing the power, the deposited rate is increased. It was found that at the target-substrate distance of 16 cm and the deposited pressure of 0.1 mbar give the lowest deposited rate (1.7 nm/min) with the films thickness of 50 nm. Mechanism possibility will be discussed.

Keywords: ZnO thin films, dc magnetron sputtering, ceramic target

¹ Department of Physics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University

² Science Division, Patai Udom Suksa School, Bangkok

* Corresponding author, email: thanapor@swu.ac.th

บทนำ

ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้งานฟิล์มออกไซด์โปร่งใส naïไฟฟ้า (Transparent Conductive Oxide films : TCO) อย่างแพร่หลาย เช่น ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ – อิเล็กทรอนิกส์ (opto-electronic devices) อุปกรณ์อ่อนแกนิกไลท์ – อิมิตติง (organic light – emitting devices) และอิเล็กทรอนิกส์โปร่งใสในเซลล์แสงอาทิตย์เป็นต้น เนื่องจากฟิล์มออกไซด์โปร่งใส naïไฟฟ้า มีสภาพด้านท่านไฟฟ้าต่ำ ความโปร่งใสสูง ในช่วงความถี่แสงและช่วงความถี่ไกลอนฟราเรด [1] โดยในเชิงพาณิชย์ฟิล์มออกไซด์โปร่งใส naïไฟฟ้าส่วนใหญ่ทำจากฟิล์มมอนเดียมทินออกไซด์ (ITO) และฟิล์มทินออกไซด์ (SnO_2) ซึ่งมีราคาแพง

อย่างไรก็ตามในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาฟิล์มออกไซต์โปร่งใสสำหรับที่มีส่วนประกอบเป็นซิงค์ออกไซต์ (ZnO) เพื่อใช้ทดแทนฟิล์มอินเดียมทินออกไซต์และฟิล์มทินออกไซต์ โดยฟิล์มซิงค์ออกไซต์มีข้อได้เปรียวกว่าฟิล์มดังกล่าว โดยสามารถใช้เป็นฟิล์มออกไซต์โปร่งใสสำหรับที่มีราคาถูก เพราะมีวัตถุดินเจนานามาก สามารถเตรียมได้ที่อุณหภูมิต่ำประมาณ $100 - 150^{\circ}\text{C}$ และหนทางต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นพลาสม่าของไฮโดรเจน (Hydrogen plasma) ซึ่งใช้ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอฟฟ์ซิลิกอน แม้สภาพด้านทันทานไฟฟ้าของฟิล์มซิงค์ออกไซต์ซึ่งอยู่ในช่วง $6 \times 10^{-3} - 5 \times 10^{-4} \Omega\text{cm}$ ด้อยกว่าฟิล์มอินเดียมทินออกไซต์อยู่กีต่าม แต่สภาพด้านทันทานไฟฟ้าของฟิล์มซิงค์ออกไซต์มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา 1 ปีในอุณหภูมิห้อง ดังนั้นฟิล์มซิงค์ออกไซต์จึงเหมาะสมที่จะนำมาใช้แทนฟิล์มอินเดียมทินออกไซต์และฟิล์มทินออกไซต์

โดยทั่วไปสมบัติของพิล์มชิงค์ก็ออกไชร์ดขึ้นกับเงื่อนไขในการเตรียมพิล์ม โดยมีรายงานว่าสามารถทำให้สภาพด้านทานไฟฟ้าของพิล์มชิงค์ออกไชร์ดลดลงได้จากการเติมสารเจือเช่นอลูมิเนียม ฟลูออไรด์ แกลเลียมและอินเดียม [2-5] และมีรายงานว่าอุณหภูมิของแผ่นรองรับที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อคุณสมบัติของพิล์มที่ได้โดยการเป็นผลึกของพิล์มเดือน ขนาดเกรนเพิ่มขึ้น สภาพด้านทานไฟฟ้าลดลง [6-8] โดยในการเตรียมพิล์มชิงค์ออกไชร์ดป้องใส่น้ำไฟฟ้านี้สามารถเตรียมได้หลายวิธี เช่น วิธีสเปรย์ไฟโรไลซิส (spray pyrolysis) วิธีพัลส์ เลเซอร์ เดพโพไซชัน (pulsed laser deposition) วิธีเคมีดิก เดพโพไซชัน (cathodic deposition) และวิธีสปั๊ตเตอริง (sputtering)

สำหรับวิธีสปัตเตอร์ริงนั้นงานวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นเตรียมพิล์มบางโดยใช้เทคนิค อาเอฟ แมกนีตอวน สปัตเตอร์ (rf magnetron sputtering) ซึ่งใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าความถี่สูงในย่านความถี่วิทยุ โดยใช้เป้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าหรืออนวน จึงมีนักวิจัยหลายกลุ่มใช้เป้าที่เป็นอนวนเข่นเชรามิกส์ชิงค์ออกไซด์เพื่อตัวอยู่ลูมิเนียร์ที่ผ่านการเผาเผา [9-11] โดยเทคนิคนี้มีอัตราการหับถมพิล์มต่ำและราคาแพง สำหรับการเตรียมพิล์มบางด้วยเทคนิค ดีซี แมกนีตอวน สปัตเตอร์ (dc magnetron sputtering) ใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง โดยเป้าที่ใช้ต้องเป็นตัวนำไฟฟ้าเท่านั้น ดังนั้น หากต้องการเตรียมพิล์มชิงค์ออกไซด์จึงต้องใช้โลหะชิงค์เป็นเป้าและเพิ่มก๊าซไวปฏิกิริยา เช่นออกซิเจนเข้าไปในระบบ สปัตเตอร์ ซึ่งพิล์มที่ได้ไม่เสียรักษาแล้วเพิ่มก๊าซไวปฏิกิริยา เช่นออกซิเจนเข้าไปในระบบ สปัตเตอร์ ไม่สามารถใช้โลหะชิงค์เป็นเป้าและเพิ่มก๊าซไวปฏิกิริยา เช่นออกซิเจนเข้าไปในระบบ สปัตเตอร์ ได้ แต่สามารถใช้โลหะชิงค์เป็นเป้าและเพิ่มก๊าซไวปฏิกิริยา เช่นออกซิเจนเข้าไปในระบบ สปัตเตอร์ ได้ แต่ต้องใช้โลหะชิงค์ออกไซด์สามารถเปลี่ยนได้ง่ายโดยการออกซิไดซ์ของโลหะชิงค์บันผิวหน้าเป้า [12] อย่างไรก็ตามระบบดีซี แมกนีตอวน สปัตเตอร์นี้มีข้อได้เปรียบคือมีอัตราการหับถมสูง มีราคาถูกและเป็นเทคนิคที่ง่ายไม่ слับซับซ้อน สำหรับการเตรียมพิล์มโดยใช้เป้าเป็นเชรามิกส์ในระบบ ดีซี แมกนีตอวน สปัตเตอร์นั้น มีเงื่อนไขค่อนข้างจำกัด โดยจะต้องเตรียมเป้าเชรามิกส์ให้นำไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมในการใช้งานในระบบ ดีซี แมกนีตอวน สปัตเตอร์ ไม่ใช่เรื่องนั้นจะไม่เกิดการโกลว์ ดิสชาต์จ์ (Glow Discharge) และไม่เกิดการหับถมของพิล์ม หรือเกิดการอาร์คทำให้พิล์มมีคุณสมบัติที่ไม่พึงประสงค์ จากการศึกษาที่ผ่านมา [13] พบว่าการเตรียมพิล์มบางชิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยลูมิเนียร์โดยใช้เป้าเชรามิกส์โดยเทคนิค ดีซี แมกนีตอวน สปัตเตอร์ จะให้พิล์มที่มีองค์ประกอบทางเคมีใกล้เคียงกันและใกล้เคียงกับเป้าแม้จะเตรียมด้วยเงื่อนไขต่างกัน โดยการศึกษาจากเทคนิคเอกซ์เรย์ โฟโตอิเล็กตรอน สเปคโทรสโคปี (X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS) และมีความบริสุทธิ์สูงเนื่องจากเตรียมในสูญญากาศ โดยจากการวิจัยที่ผ่านมา [14] พบว่าวิธีการเตรียมเชรามิกส์เพื่อใช้เป็นเป้าก็เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากที่จะทำให้เกิดการโกลว์ดิสชาต์ที่ดี

ในระบบสปัตเตอริ่ง มีอัตราการทับถมของฟิล์มตี่และได้ฟิล์มที่มีคุณภาพสูง โดยการเตรียมเซรามิกส์ในเชิงพานิชย์นั้นมีหลายวิธี เช่นวิธีการเผาผ่านแบบปกติ (normal sintered) วิธีการเผาผ่านแบบอ่อน (soft sintered) และวิธีการยัดด้วยความร้อน (Hot pressed)

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาการเตรียมฟิล์มบางชิ้งค์ออกไซด์เจือด้วยอลูมิเนียมและอินเดียม (Aluminum and Indium doped Zinc oxide film : AlZO) ด้วยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง โดยใช้เป้าเซรามิกส์นาไฟฟ้าที่เตรียมเองในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตและลดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบ เป้าว่ามีความเหมาะสมใช้งานในระบบ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริ่งอย่างไร โดยศึกษาจากการสปัตเตอริ่งในอุ่นไห้ต่างๆ ที่ทำให้เกิดฟิล์ม อัตราการทับถมและลักษณะของฟิล์มที่ได้และหาเงื่อนไขการสปัตเตอริ่งที่ดีที่สุดที่ให้ฟิล์มที่มีลักษณะพึงประสงค์เช่นมีความหนาตั้งแต่ 700 nm มีอัตราการทับถมตี่และมีลักษณะโปร่งใส เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสงของฟิล์มในงานวิจัยข้างต่อไป

วิธีการทดลอง

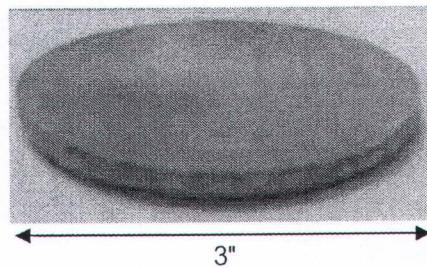
1. การเตรียมเซรามิกส์ AlZO เพื่อใช้เป็นเป้าในระบบดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง

เพื่อให้เซรามิกส์ชิ้งค์ออกไซด์และฟิล์มที่ได้สามารถนำไฟฟ้าได้ดีจึงเจือด้วยอลูมิเนียมและอินเดียมในปริมาณ 0.5 wt% โดยงานวิจัยนี้ได้เลือกเตรียมเซรามิกส์แบบวิธีการเผาผ่านแบบปกติ ซึ่งมีขั้นตอนการเตรียมเป้าเพื่อให้นำไฟฟ้าดังนี้

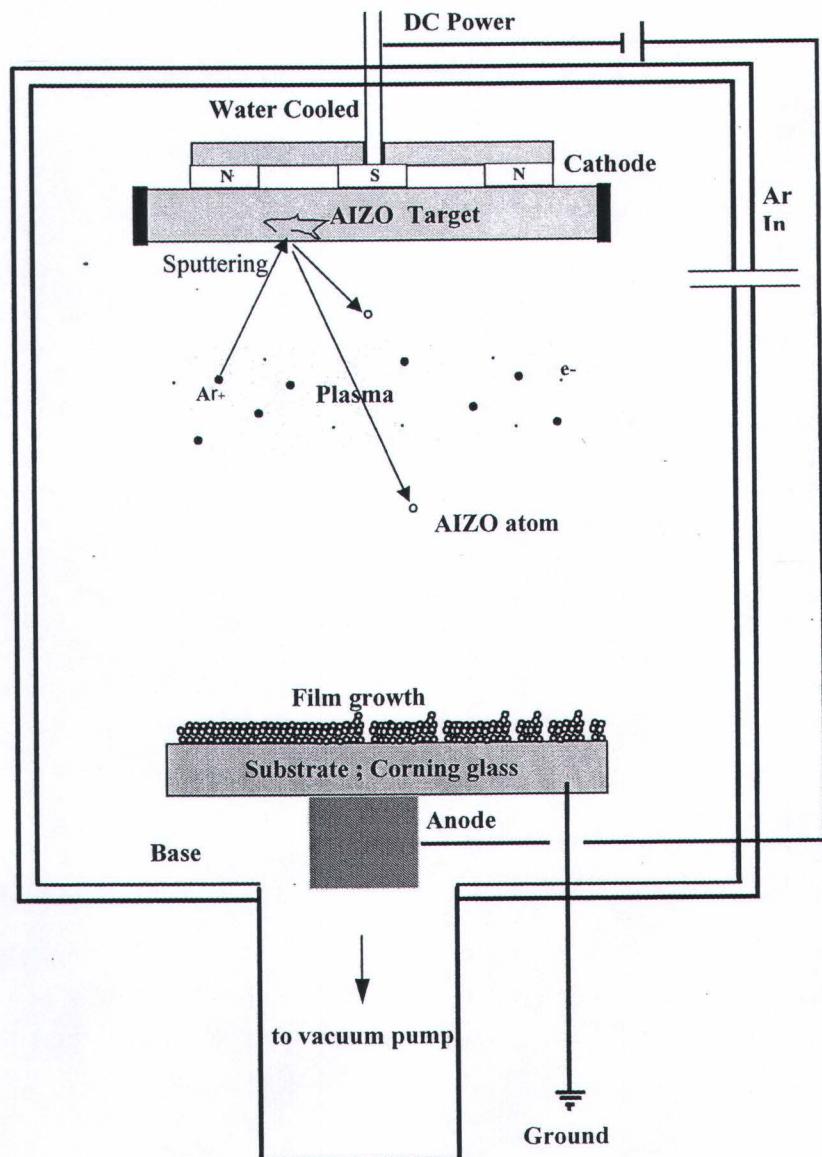
- 1) ชั้งชิงค์ออกไซด์ (ZnO) ความบริสุทธิ์ 99.99 % ในปริมาณ 148.5 g อลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3) ความบริสุทธิ์ 99.99 % ในปริมาณ 0.75 g และอินเดียมออกไซด์ (In_2O_3) ความบริสุทธิ์ 99.99 % ในปริมาณ 0.75 g
- 2) ผสมสารทั้งหมดลงในกระป๋องพลาสติก ใส่มีดบดเซอร์โคเนีย และเติมເອການອลงไว้ ปิดฝาภาชนะให้สนิท แล้วนำไปหมุนบดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- 3) นำสารที่หมุนบดครบตามเวลาแล้วมาทำการระเหยເອການอลอกโดยใช้เตาแห่นความร้อน (hot plate) และแท่งแม่เหล็กวนขณะให้ความร้อนจนสารผสานแห้งสนิท
- 4) นำสารผสมมาบดด้วยครกบดให้ละเอียด
- 5) นำสารผสมที่ได้มาอัดขึ้นรูปในโมล (mold) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 นิ้ว ด้วยแรงอัด 1 ดัน ใช้เวลาอัด 30 นาที
- 6) นำสารผสมที่อัดขึ้นรูปไปเผาผ่านแก้วที่อุณหภูมิ 1,320 °C เป็นเวลา 8 ชั่วโมง เพื่อให้ผนึกตัวเป็นเซรามิกส์ หลังจากกระบวนการเผาเสร็จสิ้นเซรามิกส์จะดัดด้วยเหลือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว
- 7) ขัดผิวด้านหนึ่งของเซรามิกส์เพื่อให้ได้รูบแบบด้วยกระดาษทรายน้ำ จากนั้นจึงนำเซรามิกส์ไปอบไล์ ความชื้นที่อุณหภูมิ 150 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
- 8) ทากราฟิน (silver paint) ที่เซรามิกส์ด้านที่ถูกขัดให้ได้รูบ เพื่อให้เซรามิกส์นำไฟฟ้าได้ขึ้นเมื่อนำไปใช้งานเป็นขั้วคาโทดในระบบ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง จากนั้นจึงนำไปเผาที่อุณหภูมิ 600 °C เป็นเวลา 15 นาที ก็เป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการเตรียมเป้าเซรามิกส์

2. การใช้เซรามิกส์ AlZO เป็นเป้าเพื่อเตรียมฟิล์มบาง AlZO ด้วยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริ่ง

เซรามิกส์ AlZO ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วที่เตรียมจากการทดลอง 1 มีสภาพด้านท้ายไฟฟ้าเป็น 905 Qcm ลักษณะเป็นแผ่นกลม หนา 0.7 cm (ดังรูปที่ 1) ใช้เซรามิกส์ AlZO เป็นเป้าในระบบดีซี แมกนีตรอนสปัตเตอริ่ง เพื่อให้เกิดฟิล์มเคลือบบนแผ่นรองรับซึ่งเป็นกระจกคอร์นนิ่ง (corning glass) ขนาด 7.5 x 2.5 cm ผลิตโดยบริษัท คอร์นนิ่ง ประเทศไทย เนื่องจากฟิล์มน้ำจะแตกหักหากติดต่อกันนานๆ ทำให้ฟิล์มไม่สามารถส่องประกายได้ ทราบผู้ที่มี



รูปที่ 1 เป้าเซรามิกส์นำไปฟื้นฟูชิ้นส่วนของไซด์เจ็ดด้วยอัลูมิเนียมและอินเดียม



รูปที่ 2 แผนผังระบบ ดีซี แมgnีตอรอน สปัตเตอริง โดยใช้เป้าเซรามิกส์ AIZO เป็นขั้วคาโทดและแผ่นรองรับซึ่งเป็นกระดาษครุภัณฑ์เป็นขั้วอาโนด

สารอินทรีย์ต่างๆ เพื่อให้ได้ฟิล์มที่เคลือบยึดติดแน่นบนผิวกระดาษ ซึ่งมีขั้นตอนการทำความสะอาด โดยเริ่มจากนำกระเจาคอร์นนิ่งล้างด้วยน้ำยาล้างจานเพื่อขัดผุน และคราบไขมันแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าตามด้วยน้ำกลิ้น (distilled water : DI) จากนั้นนำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยอัลตราโซนิกโดยใช้น้ำกลิ้น อะซีโตน และไอโซพร็อกอลกอฮอล์ (IPA) ชนิดละ 30 นาที และเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษเช็ดเลนส์แล้วจึงนำกระเจาคอร์นนิ่งใส่ในภาชนะสูญญากาศ (chamber) เพื่อใช้เป็นแผ่นรองรับในการสปัตเตอร์링ต่อไป

สำหรับการเตรียมฟิล์มด้วยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอร์ิง โดยให้เป้าเซรามิกส์นำไฟฟ้าต่อ กับขั้วคาด และให้กระเจาคอร์นนิ่งซึ่งเป็นแผ่นรองรับต่อ กับขั้วขาโนด (ดังรูปที่ 2) โดยให้เงื่อนไขการสปัตเตอร์ิงต่างๆ เช่นระห่ำที่ระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับตั้งแต่ 7-16 cm กำลังไฟฟ้า 30 – 50 W และความดันขณะสปัตเตอร์ิงต่างๆ ทำการสปัตเตอร์ิงที่อุณหภูมิห้อง โดยมีความดันในภาชนะสูญญากาศก่อนการสปัตเตอร์ิง (base pressure) เป็น 6×10^{-5} mbar ใช้ก๊าซ氩กอนบีสุทธิ์เป็นไอโอนที่ระดมยิงเป้าและใช้เวลาในการสปัตเตอร์ิง 30 นาที ทำการสปัตเตอร์ผิวหน้าเป้าทึ้งก่อน (pre-sputtering) เป็นเวลา 10 นาทีโดยใช้ชัตเตอร์ปิดหน้าแผ่นรองรับไว้

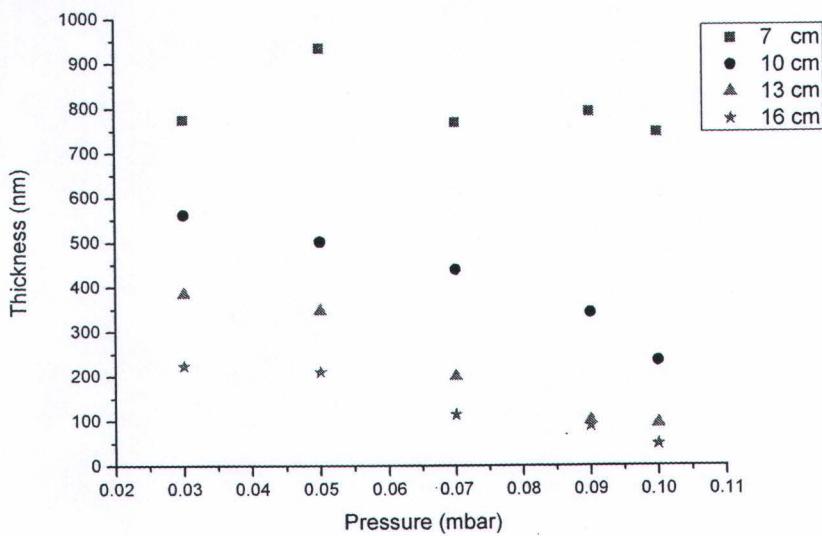
ตรวจสอบการเกิดโกล์ว ดิสชาจต์ ขณะเริ่มสปัตเตอร์ิง และเงื่อนไขการสปัตเตอร์ิงต่างๆ ที่ทำให้เกิดฟิล์ม ตรวจสอบลักษณะกายภาพเช่นความโปร่งใสของฟิล์มด้วยสายตา จากนั้นจึงวัดความหนาของฟิล์มบนแผ่นรองรับด้วย เครื่องวัดความหนาของฟิล์ม (Surface profiler) ผลิตโดยบริษัทวีโก (Veeco) รุ่น Dektak 150 และศึกษาภาคตัดขวางของฟิล์มด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าด (scanning electron microscopy : SEM) ผลิตโดยบริษัทอาชิ (Hitachi) รุ่น S4700

ผลการทดลอง

จากการใช้เซรามิกส์นำไฟฟ้า AIZO ที่เตรียมเองในห้องปฏิบัติการเป็นเป้าในระบบ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอร์ิง นั้นพบว่าการโกล์ว ดิสชาจต์จะเกิดที่ความดันตั้งแต่ 3×10^{-2} mbar เป็นต้นไป โดยระห่ำที่ระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับที่สั้นที่สุดที่เกิดการโกล์ว ดิสชาจต์คือ 7 cm แต่ที่ระห่ำนี้การโกล์ว ดิสชาจต์ ณ ความดันต่ำๆ มีข้อจำกัดคือไม่สามารถเกิดต่อเนื่องเป็นเวลานานได้ และกำลังไฟฟ้าต่ำสุดที่เกิดการโกล์ว ดิสชาจต์คือ 30 W โดยทุกเงื่อนไขการสปัตเตอร์ิงจะได้ฟิล์มบางโปร่งใสบนแผ่นรองรับ โดยมีความหนาต่างกันซึ่งขึ้นกับเงื่อนไขการเตรียมฟิล์มดังนี้

1. ผลของระห่ำที่ระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับและความดันที่มีต่อความหนาของฟิล์ม

อันดับแรกวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติและการทับถมของฟิล์ม จากรูปที่ 3 แสดงถึงอิทธิพลของระห่ำที่ระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับและความดันขณะสปัตเตอร์ที่ส่งผลต่อการทับถมของฟิล์ม พนับว่าเมื่อความดันเพิ่มขึ้น ความหนาของฟิล์มมีแนวโน้มลดลง โดยเห็นได้ชัดเจนเมื่อระห่ำที่ระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 10, 13 และ 16 cm ตามลำดับ ซึ่งอธิบายได้จากเมื่อให้ศักย์ไฟฟาระห่ำกว่าโนดและคาดจนถึงแรงดันพังทลาย พลังงานของประจุถูกเร่งภายในไฟฟ้าจะมีค่าสูงขึ้น สามารถชนกับโนมูลของก๊าซาร์กอนซึ่งเป็นก๊าซเฉื่อยในภาชนะสูญญากาศทำให้โนมูลของก๊าซาร์กอนกิดการแตกตัวเป็นอิเล็กตรอนและไอโอนบวก เกิดการไออ่อนในร่องรอยของเป้าถูกสปัตเตอร์ออกมาระตกลงบนแผ่นรองรับ เมื่อความดันเพิ่มขึ้นทำให้มีไอโอนของอาร์กอนในพลาสม่าเพิ่มขึ้น จึงทำให้อะตอมของเป้าที่ถูกสปัตเตอร์ออกมานั้นกับไอโอนของอาร์กอนในพลาสม่าและสูญเสียพลังงานเนื่องจากการชนและมีพลังงานไม่พอที่จะตกลงบนแผ่นรองรับ ทำให้อัตราการทับถมลดลง ความหนาของฟิล์มจึงลดลงตามลำดับขณะที่ระห่ำที่ระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 7 cm ความดันที่เพิ่มขึ้นจาก 0.03 ถึง 0.1 mbar กลับไม่ส่งผลต่อการทับถมของฟิล์ม โดยฟิล์มมีความหนาระห่ำ 750-950 nm และมีอัตราการทับถมดีที่สุด (25-32 nm/min) ทั้งนี้เนื่องจากระห่ำที่ระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับที่ใกล้กันมาก ทำให้อะตอมของเป้าที่ถูกสปัตเตอร์ออกมาระตกลงบนแผ่น



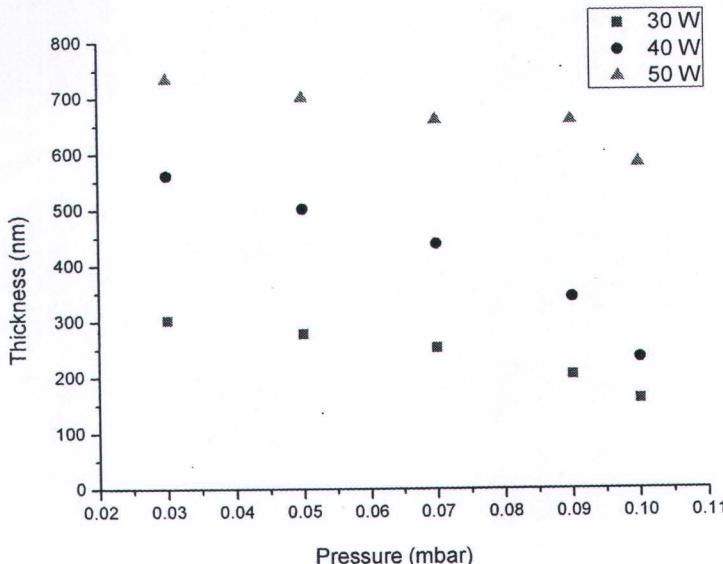
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสปัตเตอริ่งที่มีต่อความหนาของฟิล์ม AlZO เตรียมที่กำลังไฟฟ้า 40 W โดยมีระยะห่างระหว่างเป้ากันแผ่นรองรับเป็น 7 10 13 และ 16 cm ตามลำดับ

รองรับกันที่โดยไม่สูญเสียพลังงานเนื่องจากการชนกับไออกอนของอาร์กอนแม้ที่ความดันสูง จึงมีการทับถมของอะตอมที่ถูกสปัตเตอร์ออกมาก ส่งผลให้ได้ฟิล์มหนา

จากการทดลองยังพบว่าระยะห่างระหว่างเป้ากันแผ่นรองรับที่ต่างกันยังส่งผลต่อความหนาของฟิล์ม โดยระยะห่างมาก ความหนาของฟิล์มลดลง โดยฟิล์มเตรียมที่ระยะห่างระหว่างเป้ากันแผ่นรองรับมากถึง 16 cm ความดัน 0.1 mbar จะมีอัตราการทับถมต่ำสุด (1.7 nm/min) และมีความหนาเป็น 50 nm ซึ่งอธิบายได้จากที่ระยะห่างระหว่างเป้ากันแผ่นรองรับมาก อะตอมของเป้าที่ถูกสปัตเตอร์ออกมีโอกาสสูญเสียพลังงานจากการชนกับไออกอนของอาร์กอนในพลาสมามากกว่าที่ระยะใกล้ทำให้อัตราการทับถมลดลง ความหนาของฟิล์มจึงลดลง

จากผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงระยะห่างระหว่างเป้ากันแผ่นรองรับและความดันขณะสปัตเตอร์นั้นมีผลต่ออัตราการทับถมของฟิล์มซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ S.H. Jeong และคณะ [15]

2. ผลของกำลังไฟฟ้าที่มีต่อความหนาของฟิล์ม

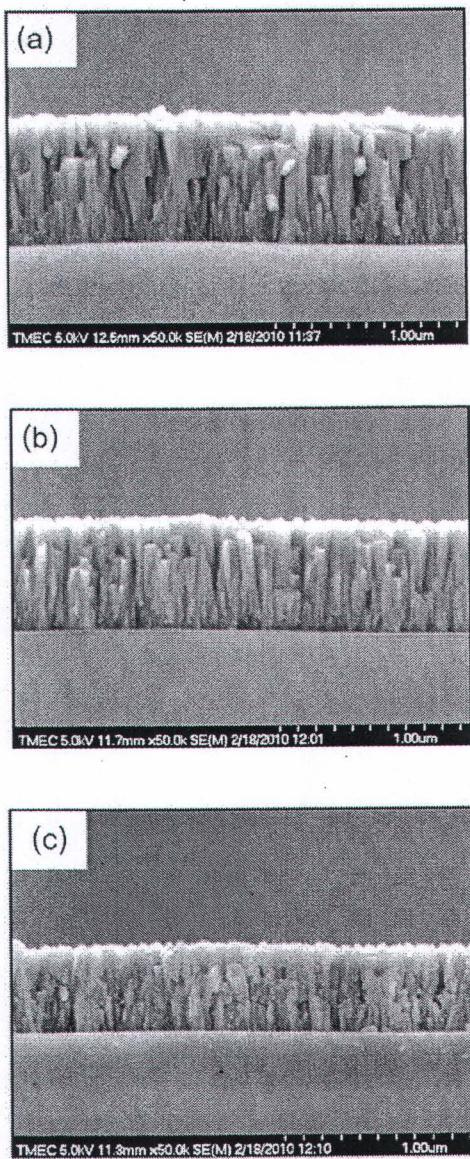


รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสปัตเตอริงที่มีต่อความหนาของฟิล์ม AlZO เตรียมที่กำลังไฟฟ้า 30 40 และ 50 W โดยมีระยะห่างระหว่างเป้ากันแผ่นรองรับเป็น 10 cm

จากรูปที่ 4 แสดงถึงอิทธิพลของกำลังไฟฟ้าและความดันที่มีต่อการทับถมของฟิล์ม โดยเตรียมฟิล์มที่ระยะห่างระหว่างเป้ากันแผ่นรองรับเป็น 10 cm ด้วยกำลังไฟฟ้า 30 40 และ 50 W ที่ความดันต่างๆ พบว่าตัวอย่างที่เตรียมด้วยกำลังไฟฟ้า 30 W เมื่อเพิ่มความดันความหนาของฟิล์มจะลดลงตามลำดับ โดยมีผลการทดลองที่สอดคล้องกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมด้วยกำลังไฟฟ้า 40 หรือ 50 W และสอดคล้องกับผลการทดลองที่ 1 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าที่กำลังไฟฟ้าสูงถึง 50 W ความดันที่สูงขึ้นมีผลต่อการทับถมของฟิล์มน้อยมาก

จากการทดลองกำลังไฟฟ้าส่างผลต่อความหนาของฟิล์มเช่นกัน โดยฟิล์มที่เตรียมด้วยกำลังไฟฟ้าสูงกว่าจะมีความหนาเพิ่มขึ้นตามลำดับในทุกด้วยตัวอย่างที่เตรียมด้วยความดันเดียวกัน เนื่องจากกำลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเร่งไอโอนให้เคลื่อนที่ด้วยพลังงานสูงเมื่อเกิดการชนและถ่ายเทโมเมนตัมกับอะตอมผิวน้ำเป้าจะส่งผลให้อะตอมผิวน้ำ เป้ามีพลังงานการเคลื่อนที่ที่สูงขณะตกเคลื่อนบนแผ่นรองรับ [16] จึงทำให้ได้ฟิล์มที่มีความหนากว่าตัวอย่างที่เตรียมด้วยกำลังไฟฟ้าต่ำ โดยเงื่อนไขการสปัตเตอริงที่ดีที่สุดคือที่กำลังไฟฟ้า 50 W ในช่วงความดัน 0.03-0.10 mbar โดยมีอัตราการทับถมสูงสุด (21-24 nm/min) และให้ความหนาของฟิล์มในช่วง 630-730 nm/min

3. โครงสร้างจุลภาคของฟิล์ม



รูปที่ 5 ภาพตัดขวางของฟิล์มบาง AlZO ที่เตريยมด้วยกำลังไฟฟ้า 50 W ระยะห่างระหว่างเป้ากันแผ่นรองรับ 10 cm โดยมีความดันเป็น (a) 3×10^{-2} (b) 7×10^{-2} และ (c) 1×10^{-1} mbar ตามลำดับ

จากรูปที่ 5 ชี้งแสดงภาพตัดขวางของฟิล์มบาง AlZO ที่เตريยมด้วยความดัน 3×10^{-2} 7×10^{-2} และ 1×10^{-1} mbar ตามลำดับ พนว่าฟิล์ม AlZO ที่เตريยมด้วยความดัน 3×10^{-2} mbar มีลักษณะการก่อตัวของฟิล์มเป็นแท่งเรียวที่หนาแน่น และสม่ำเสมอโดยมีความหนา 730 nm ตัวอย่างที่เตريยมด้วยความดัน 7×10^{-2} mbar การก่อตัวของฟิล์มมีลักษณะเป็นแท่งเรียวไม่สม่ำเสมอ โดยมีความหนาเป็น 660 nm และตัวอย่างที่เตريยมด้วยความดัน 1×10^{-1} mbar เนื้อฟิล์มที่ก่อตัวขึ้นมีลักษณะไม่เป็นแท่งเรียวซัดเจนและไม่หนาแน่น โดยเกากันอย่างหลวงๆ มีช่องว่างเล็กๆ แทรกในเนื้อฟิล์มจำนวนมากและมีความหนาเป็น 580 nm

ภาพจาก SEM แสดงให้เห็นว่าความดันส่งผลต่อการเติบโตของฟิล์ม สำหรับฟิล์มที่เตรียมด้วยความดันสูงซึ่งมีปริมาณไอออกอนมาก เมื่อเกิดการสปัตเตอริ่งจะลดลงที่หลุดจากผิวน้ำเปล่าจึงมีโอกาสสูญเสียพลังงานจากการชนกับไอออกอนตากเคลือบบนแผ่นรองรับ พลังงานจะสูญเสียไปตามสารเคลือบลดลง มีสัมประสิทธิ์การแพร่ต่ำทำให้เกิดการเกาะกันเป็นกลุ่มกระจัดกระจาย ส่งผลให้มีอัตราการหับถมต่ำและมีความหนาแน่นน้อย ขณะที่ฟิล์มที่เตรียมด้วยความดันต่ำซึ่งจะลดลงที่หลุดออกจากผิวน้ำเปล่ามีพลังงานสูงกว่า จึงทำให้ได้ฟิล์มที่มีความหนาแน่นมากกว่าฟิล์มที่เตรียมด้วยความดันต่ำ โดยผลที่ได้สอดคล้องกับการวัดความหนาของฟิล์มดังได้กล่าวไว้ด้านบน

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง

ได้ประสบความสำเร็จในการใช้เป้าเซรามิกส์ที่เตรียมเองในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในระบบดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริ่ง โดยสามารถเตรียมฟิล์มบาง AIZO บนกระจกคอร์นนิ่งได้ จากการทดลองพบว่าเมื่อทำการเตรียมฟิล์มเข่นความดัน กำลังไฟฟ้าและระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการหับถมเป็นฟิล์มต่างกันโดยที่ระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับและความดันที่มากขึ้น จะทำให้อัตราการหับถมที่หลุดออกจากผิวน้ำเปล่าสูญเสียพลังงานเนื่องจากการชนกับไอออกอนในพลาสมาระหว่างทางมายังแผ่นรองรับ ทำให้การหับถมของฟิล์มน้อยลง ความหนาลดลง ในขณะที่ระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับสั้น ความดันต่ำและกำลังไฟฟ้าที่สูงจะให้ฟิล์มที่มีความหนามากขึ้น โดยเมื่อเทียบกับฟิล์มที่มีอัตราการหับถมสูง (21-24 nm/min) เกิดการโอลร์ ติดชาตื้อย่างต่อเนื่อง คือระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 10 cm ที่ความดันระหว่าง 0.03-0.09 mbar และกำลังไฟฟ้า 50 W

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLARTEC) ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องวัดความหนาของฟิล์ม ขอขอบคุณคุณธัญญา นิลกัมาร และคุณเสริมสุข เรืองรัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค งานวิจัยนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์สำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา จำกงบประมาณเงินรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2553

เอกสารอ้างอิง

1. Jeong, W.J. and Park, G.C. 2001. Electrical and Optical Properties of ZnO Thin Film as a Function of Deposition Parameters. *Solar Energy Materials and Solar Cells.* 65: 37.
2. Nunes, P., Fortunato, E., Vilarinho, P. and Martins, R. 2001. Effect of Different Dopants on the Properties of ZnO Thin Films. *International Journal of Inorganic Materials.* 3: 1211.
3. Tsai, Y.Z., Wang, N.F. and Tsai, C.L. 2009. Formation of F-Doped ZnO Transparent Conductive Films by Sputtering of ZnF₂. *Materials Letters.* 63: 1621.
4. Song, P.K., Watanabe, M., Kon, M., Mitsui, A. and Shigesato, Y. 2002. Electrical and Optical Properties of Gallium-Doped Zinc Oxide Films Deposited by DC Magnetron Sputtering. *Thin Solid Films.* 411: 82.
5. Lee, C., Lim, K. and Song, J. 1996. Highly Textured ZnO Thin Films Doped with Indium Prepared by the Pyrosol Method. *Solar Energy Materials and Solar Cells.* 43: 37.
6. Zeng, J.N., Low, J.K., Ren, Z.M., Liew, T. and Lu, Y.F. 2002. Effect of Deposition on Optical and Electrical Properties of ZnO Films Prepared by Pulsed Laser Deposition. *Applied Surface Science.* 197-198: 362.
7. Xu, X.L., Lau, S.P., Chen, J.S., Sun, Z., Tay, B.K. and Chai, J.W. 2001. Dependence of Electrical and



- Optical Properties of ZnO Films on Substrate Temperature. *Materials Science in Semiconductor Processing*. 4: 617.
8. Igasaki, Y., Naito, T., Murakami, K. and Tomoda, W. 2001. The Effects of Deposition Conditions on the Structural Properties of ZnO Sputtered Films on Sapphire Substrates. *Applied Surface Science*. 169-170: 512.
 9. Fang, G.J., Li, D. and Yao, B.L. 2002. Influence of Post-Deposition Annealing on the Properties of Transparent Conductive Nanocrystalline ZAO Thin Films Prepared by RF Magnetron Sputtering with Highly Conductive Ceramic Target. *Thin Solid Films*. 418: 156.
 10. Jeong, S.H., Lee, J.W., Lee, S.B. and Boo, J.H. 2003. Deposition of Aluminum-Doped Zinc oxide films by RF Magnetron Sputtering and Study of their Structural, Electrical and Optical Properties. *Thin Solid Films*. 435: 78.
 11. Kluth, O., Schöpe, G., Hüpkes, J., Agashe, C., Müller, J. and Rech, B. 2003. Modified Thornton Model for Magnetron Sputtered Zinc Oxide: Film Structure and Etching Behavior. *Thin Solid Films*. 442: 80.
 12. Fang, G., Li, D. and Yao, B.L. 2003. Fabrication and Vacuum Annealing of Transparent Conductive AZO Thin Films Prepared by DC Magnetron Sputtering. *Vacuum*. 68: 363.
 13. Tohsophon, T. 2006. Structure and Properties of Aluminum Dopes Zinc Oxide Transparent Conductive Thin Films Prepared by Sputtering Technique. Dissertation (Materials Science). ChiangMai University.
 14. Tohsophon, T., Hüpkes, J., Siekmann, H., Rech, B., Schultheis, M. and Sirikulrat, N. 2008. High Rate Direct Current Magnetron Sputtered and Texture-Etched Zinc Oxide Films for Silicon Thin Film Solar Cells. *Thin Solid Films*. 516: 4628.

ได้รับบทความวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
ยอมรับดีพิมพ์วันที่ 30 กันยายน 2553

